

(Inoffizielle Übersetzung)

Bekanntmachung des Board of Investment

Nr. Sor. 6/2564

Änderung der Investitionsförderung der Halbleiterindustrie

Im Zusammenhang mit der Bekanntmachung des Board of Investment Nr. 2/2557 vom 3. Dezember 2014 zu den Richtlinien und Kriterien für die Investitionsförderung und gemäß des Abschnitts 16 des Investment Promotion Act 2520 (1977), gibt das Board of Investment Folgendes bekannt:

1. Die geförderten Aktivitäten werden geändert und die Inhalte in den Aktivitäten 5.4.9, 5.4.12 und 5.4.15 in der Liste der Aktivitäten, die der Bekanntmachung des Board of Investment Nr. 2/2557 vom 3. Dezember 2014 beigelegt sind, werden aufgehoben und durch die folgenden Bestimmungen ersetzt:

Aktivitäten	Bedingungen	Anreize
5.4.9 Herstellung von Halbleitern und/oder Teilen für Halbleiter, einschließlich Produkten, die zwischen Herstellungsprozessen entstanden sind oder nachgelagerten Produkten wie z.B. Waferschleifen, gesägten Würfeln, Wafertests, IC-Tests, IC-Modulen usw.	Bei der Produktion von integrierten Schaltungen gelten die Kosten für die Aufarbeitung bestehender Maschinen als Investition und werden bei der Berechnung der Körperschaftsteuerbefreiungsgrenze berücksichtigt. Die Anschaffungskosten bestehender Maschinen gelten nicht als Investition.	
5.4.9.1 Herstellung von Halbleitern und/oder Teilen für Halbleiter, einschließlich Produkten, die zwischen Herstellungsprozessen entstanden sind oder nachgelagerten Produkten wie z.B.	Das Investitionskapital für Maschinen (einschließlich Kosten für Installation und Testlauf), die im Herstellungsprozess verwendet werden, darf nicht weniger als 1.5 Milliarden Baht betragen.	A2

Aktivitäten	Bedingungen	Anreize
Waferschleifen, gesägten Würfeln, Wafertests, IC-Tests, IC-Modulen, usw., die eine Großinvestition darstellen 5.4.9.2 Herstellung von Halbleitern und/oder Teilen für Halbleiter, einschließlich Produkten, die zwischen Herstellungsprozessen entstanden sind oder nachgelagerten Produkten wie z.B. Waferschleifen, gesägten Würfeln, Wafertests, IC-Tests, IC-Modulen, usw.		A3
5.4.12 Herstellung von flexiblen Leiterplatten und/oder Leiterplatten und/oder Teilen 5.4.12.1 Herstellung von flexiblen Leiterplatten und/oder mehrschichtigen Leiterplatten und/oder Teilen, die eine Großinvestition darstellen 5.4.12.2 Herstellung von flexiblen Leiterplatten und/oder mehrschichtigen	Die Herstellungsverfahren müssen vom BOI genehmigt werden. Das Investitionskapital für Maschinen (einschließlich Kosten für Installation und Testlauf), die im Herstellungsprozess verwendet werden, darf nicht weniger als 1.5 Milliarden Baht betragen.	A2 A3

Aktivitäten	Bedingungen	Anreize
Leiterplatten und/oder Teilen		
5.4.12.3 Herstellung von anderen Leiterplatten und/oder Teilen		B1
5.4.14 Herstellung von Leiterplattenbestückung (PCBA) oder nachgelagerten Produkten von PCBA im selben Projekt	Die gesamte Montagelinie von PCBA muss die Surface Mount Technology im selben Projekt verwenden	A3 A4
5.4.14.1 Herstellung von Leiterplattenbestückung (PCBA) oder nachgelagerten Produkten von PCBA im selben Projekt, die eine Großinvestition darstellen	Das Investitionskapital für Maschinen (einschließlich Kosten für Installation und Testlauf), die im Herstellungsprozess verwendet werden, darf nicht weniger als 1.5 Milliarden Baht betragen.	
5.4.14.2 Herstellung von Leiterplattenbestückung (PCBA) oder nachgelagerten Produkten von PCBA im selben Projekt		

2. Um das Potenzial und die nationale Wettbewerbsfähigkeit in Bereich von fortschrittlichen Technologien und Innovation zu fördern, werden die geförderten Aktivitäten geändert. Die Inhalte der Aktivität Nr. 5.5.1 in der Liste der Aktivitäten in der Bekanntmachung des Board of Investment Nr. 2/2557 vom 3. Dezember 2014 werden aufgehoben und durch die folgenden Bestimmungen ersetzt:

Aktivitäten	Bedingungen	Anreize
5.5.1 Herstellung von Wafer-Halbleitern	Die Herstellungsverfahren müssen vom BOI genehmigt werden.	10-jährige Körperschaftsbefreiung ohne Grenze

3. Diese Änderung gilt für die bis zum Datum dieser Bekanntmachung eingereichten Anträge und für die Anträge, die vor dem Datum des Inkrafttretens dieser Bekanntmachung nicht genehmigt wurden.

Diese Bekanntmachung ist ab sofort gültig.

Bekannt gegeben am 16. September 2021

General Prayuth Chan-ocha

Premierminister

Vorsitzender des Board of Investment